

**OMNIMATE Housing - CH20M sorozat
CH20M FE 12-67 1.5SN RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

**FE érintkező****Funkcionális megbízhatóság – vagy teljesen integrált, vagy egyszerűen beszerelhető**

Az opcionális "CH20M FE" csatlakozó a funkcionális földelésre használható tartósínes érintkezővel optimálisan védi az Ön rendszerét.

- A 6 mm-es házban előszerelt funkcionális földelő érintkező lehetővé teszi az elektromos áramköri árnyékolások állandó és megbízható csatlakoztatását a tartósínhez (például "CH20M6 BP 4P-4P FE BK", 1164650000)
- A funkcionális földelő érintkező, ami reflow-módszerrel teljes egészében automatikusan kezelhető a csatlakozódugókkal és az opcionális buszérintkezővel együtt, 12,5 és 67,5 mm közötti házakhoz kapható. A NYÁK pozíciója a házban megadja a 1,5 mm / 3,2 mm-es tűskehosszt

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | CH20M FE 12-67 1.5SN RL |
| Rendelési szám | 1189370000 |
| Verzió | Elektronika házak, Tartozékok, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: 1, Forrasztótűske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, Tape |
| GTIN (EAN) | 4032248972715 |
| Menny. | 750 Stück |
| Termékadatok | UL: |
| Csomagolás | Tape |

**OMNIMATE Housing - CH20M sorozat
CH20M FE 12-67 1.5SN RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 0,482 g |
|-------------|---------|

Anyagjellemzők

| | |
|-------------------|---------|
| Érintkező felület | ónozott |
|-------------------|---------|

Névleges adatok IEC szerint

| | |
|----------------------------|------------------------|
| szabvány szerint tesztelve | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|----------------------------|------------------------|

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0 | EC002637 | ETIM 5.0 | EC002637 |
| ETIM 6.0 | EC001031 | eClass 6.2 | 27-18-92-90 |
| eClass 7.1 | 27-18-92-90 | eClass 8.1 | 27-18-92-90 |
| eClass 9.0 | 27-18-27-90 | eClass 9.1 | 27-18-27-90 |

Megjegyzések

| | |
|----------------|--|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
|----------------|--|

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|--|
| Brochure/Catalogue | FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN |
| Engineering Data | STEP |

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.